



## Topniki w żelu dla BGA IF 7500HAB

INTERFLUX®  
ELECTRONICS  
N.V.



Karta techniczna IF

Ver: 3.11 27-10-15

### Bezhalogenkowy topnik w żelu typu no-clean

#### Opis:

**Interflux® IF 7500HAB** jest specjalistycznym topnikiem żelowym, nie zawierającym halogenków o zwiększonej aktywności. Topnik wykazuje właściwości reologiczne podobne do żywiczych.

**IF 7500HAB** może być aplikowany poprzez nadruk, dyspenser lub aplikację pędzelkiem.

**IF 7500HAB** jest kompatybilny ze stopami ołowiowymi oraz bezołowiowymi.

Zapewnia znakomitą zwilżalność na praktycznie wszystkich powłokach ochronnych: OSP, NiAu, I-Sn...itp.

Pozostałości są minimalne i nie wymagają czyszczenia.



Produkt na zdjęciu może się różnić od dostarczonego

#### Właściwości chemiczne i fizyczne:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Konstystencja        | : Lepka             |
| kolor                | : żółtawy           |
| Zapach               | : słodkawy, łagodny |
| Zawartość halogenków | : brak              |
| pH (5% aq.sol)       | : 3                 |
| IPC/ EN              | : RE MO             |

### Cechy charakterystyczne

#### IF 7500HAB

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Temp zapłonu             | 160 °C           |
| Rozpuszczalność w wodzie | nierozpuszczalne |
| Temp. samozapłonu        | > 204 °C         |
| Ciężar właściwy          | 1,014 g/ml       |
| Lepkość @ 20 °C          | ± 200.000 cPs    |



Str. 1

#### Więcej informacji:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Opis profilu                       | 2 |
| Profil dla aplikacji bezołowiowych | 2 |
| Profil dla aplikacji ołowiowych    | 3 |
| Testy—zgodność z normami           | 4 |
| Opakowania                         | 4 |

#### Główne zalety:

- Zwiększona aktywność
- Nie zawiera halogenków
- Doskonała zwilżalność na I-Sn, Ni/Au, OSP, Ag/Pd
- Minimalne pozostałości



## Opis profilu

### **Opis ogólny**

Zalecany jest stosowanie profilu siodełkowego. Profil siodełkowy zalecany jest przy dużym mikroskopie komponentów I dużym rozmiarze płyty lub w przypadku wymogu minimalizacji pustek.

Rozpływ bez azotu powinien nie być dłuższy niż 300sekund. Predkość transportowa powinna być skalulowana przez podzielenie długości

tunelu przez max czas profilu. Lutowanie w azocie nie ma takiego limitu. Przy lutowaniu bezołowiowych należy stosować minimalną wystarczającą temperaturę aby nie przegrzać komponentów szczególnie w piecach konwekcyjnych lub IR.

Aby uzyskać dobrą analizę termiczną PCB należy posłużyć się narzędziem do precyzyjnego pomiaru temperatury w strate-

gicznych punktach PCB (krawce panelu, najmniejsze i największe komponenty).

## Profil dla aplikacji ołowiowych

### **Preheat Aktywacja**

Od temp pokojowej do 170°C w tempie 1-3°C/s.

Szybsze podgrzewanie może doprowadzić do pęknięcia komponentów (efekt popcorn)

### **Siodło**

Od ok 160°C do 180°C w tempie 0-1°C/s. W pewnych

przypadkach strefa siodła służy wyrównaniu różnic temperatury I eliminacji pustek.

Najczęściej stosuje się siodło 20-90sekund pomiędzy 160°C-180°C.

### **Finisz do rozplwy**

Max 4°C/s z powodu różnic we współczynnikach

rozszerzalności cieplnej poszczególnych elementów układu

### **Rozpływ**

Górna temperatura powinna być zgodna ze specyfikacją komponentów. W większości jest to 200°C i 230°C. Czas przebywania

powyżej czasu płynności lutowia powinien być pomiędzy 45s a 90s.

### **Chłodzenie**

Tempo chłodzenia ok -4°C/sek.

## Profil dla aplikacji bezołowiowych

### **Aktywacja**

Od temp pokojowej do 200°C w tempie 1-3°C/s.

Szybsze podgrzewanie może doprowadzić do pęknięcia komponentów (efekt popcorn)

### **Siodło**

Od ok 180°C do 215°C w tempie 0-1°C/s. W pewnych przypadkach strefa siodła służy wyrównaniu różnic temperatury i eliminacji pustek. Najczęściej stosuje się siodło 20-90sekund pomiędzy 200°C-215°C.

### **Rozpływ**

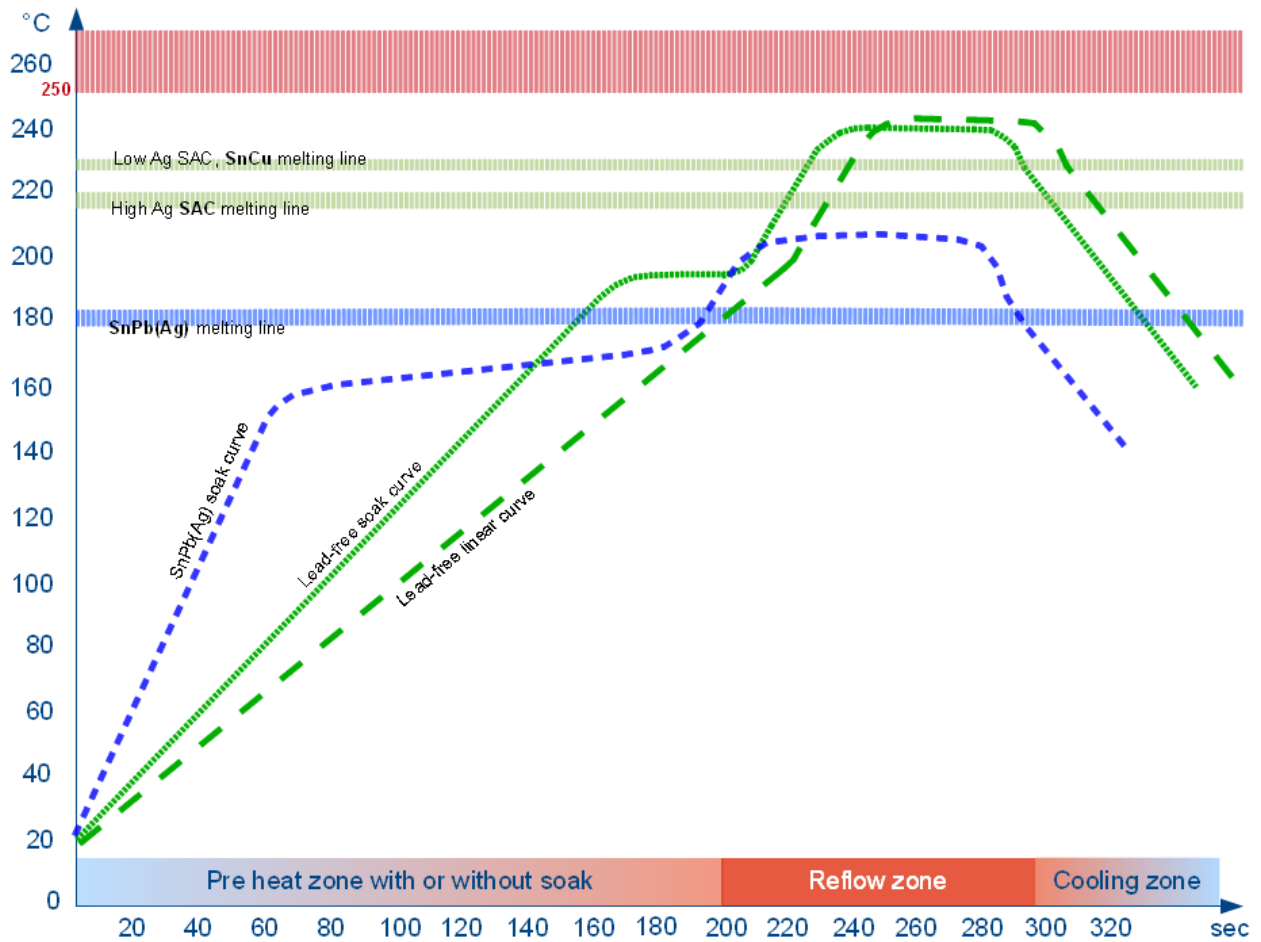
Górna temperatura powinna być zgodna ze specyfikacją komponentów. W większości jest to 235°C - 250°C. Czas przebywania powyżej czasu płynności lutowia powinien być pomiędzy 45s a 90s.

### **Chłodzenie**

Tempo chłodzenia ok -4°C/sek.



### Przykłady rekomendowanych profili





## Rezultaty testów

Zgodne z EN 61190-1-2(2002) & IPC J-STD-004A

### Chemiczne

copper mirror

**pozytyw** J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32

qualitative halide

silver chromate (Cl, Br)

**pozytyw** J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33

acid value by titration

**45,5** mg KOH/g

### Środowiskowa

SIR test

**pozytyw** J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

## Opakowanie:

Topniki IF7500 są dostępne w następujących opakowaniach:

5cc strzykawka z lub bez tłoczka

10cc strzykawka z lub bez tłoczka

30cc strzykawka z lub bez  
tłoczka

30cc słoiczek z pędzelkiem

### Disclaimer

Because Interflux® Electronics N.V. cannot anticipate or control the many different conditions under which this information and our products may be used, we do not guarantee the applicability or the accuracy of this information or the suitability of our products in any given situation. Users of our products should make their own test to determine the suitability of each such product for their particular purposes. The product discussed is sold without such warranty, either express or implied.

Copyright:

**INTERFLUX®** ELECTRONICS

Please consult the latest  
version of this document  
on:

[www.interflux.com](http://www.interflux.com)

This document in another  
language?:

[www.interflux.com](http://www.interflux.com)